

中国IC载板（封装基板）行业十四五战略规划及投资方向研究报告2024-2030年

产品名称	中国IC载板（封装基板）行业十四五战略规划及投资方向研究报告2024-2030年
公司名称	鸿晟信合研究网
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)
联系电话	18513627985 18513627985

产品详情

中国IC载板（封装基板）行业十四五战略规划及投资方向研究报告2024-2030年

【全新修订】：2024年3月

【出版机构】：中赢信合研究网

【内容部分有删减·详细可参中赢信合研究网出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：何晶晶 顾佳

包含售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员

第1章：IC载板行业综述及数据来源说明

1.1 IC载板行业界定

1.1.1 IC载板是芯片封装的核心载体

- 1、 半导体制造工艺流程
- 2、 封装的定义
- 3、 封装的功能
- 4、 封装的范围（L0、L1、L2、L3）
- 5、 IC载板（IC封装载板/封装基板）的定义
- 6、 IC载板的作用

1.1.2 IC载板的术语&概念辨析

- 1、 IC载板术语说明
- 2、 IC载板相关概念辨析
 - （1）IC载板与HDI板
 - （2）IC载板与PCB板

1.1.3 国家统计局标准中的IC载板（定义及行业归属）

1.2 IC载板行业分类

- 1.2.1 封装工艺不同
- 1.2.2 绝缘材料不同
- 1.2.3 封装方式不同
- 1.2.4 封装材料不同
- 1.2.5 应用领域不同

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 IC载板行业市场监管&标准体系

- 1.4.1 IC载板行业监管体系及机构职能（主管部门&行业协会&自律组织）
- 1.4.2 IC载板行业标准体系及建设进程（国家/地方/行业/团体/企业标准）
- 1.4.3 IC载板行业现行&即将实施标准汇总
- 1.4.4 IC载板行业重点标准及其影响解读

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告数据来源

1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

——现状篇——

第2章：全球IC载板行业发展现状及市场趋势洞察

2.1 全球IC载板行业标准体系&技术进展

2.1.1 全球IC载板行业标准体系

2.1.2 全球IC载板行业技术进展

2.2 全球IC载板行业发展历程&产品演进

2.2.1 全球IC载板行业发展历程

2.2.2 全球IC载板产品演进示意图

2.3 全球IC载板行业市场发展现状及竞争

2.3.1 全球IC载板行业市场供需状况

2.3.2 全球IC载板行业细分市场分析（产品/应用等）

2.3.3 全球IC载板企业兼并重组状况

2.3.4 全球IC载板行业市场竞争格局

2.3.5 全球IC载板行业区域发展格局

2.3.6 重点区域：日本IC载板市场分析

2.4 全球IC载板行业市场规模体量及前景预判

2.4.1 全球IC载板行业市场规模体量

2.4.2 全球IC载板行业市场前景预测（未来5年预测）

2.4.3 全球IC载板行业发展趋势洞悉

2.5 全球IC载板行业发展经验总结和有益借鉴

第3章：中国IC载板行业发展现状及市场痛点解析

3.1 中国IC载板行业发展历程分析

3.2 中国IC载板行业技术进展研究

3.2.1 IC载板行业科研投入（力度及强度）

3.2.2 IC载板行业科研创新（专利与转化）

3.2.3 IC载板行业关键技术（现状与发展）

1、IC基板制作技术

2、微孔技术

3、图形形成和镀铜技术

4、阻焊工艺

5、表面处理技术

6、检测能力和产品可靠性测试技术

3.2.4 IC载板行业技术路线（工艺与流程）

1、IC载板行业工艺类型/技术路线

（1）减除法

（2）全加成法

（3）半加成法

2、IC载板行业工艺/技术流程图解

3、IC载板行业工艺/技术路线对比

3.3 中国IC载板行业对外贸易状况

3.4 中国IC载板行业市场主体分析

3.4.1 IC载板行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）

3.4.2 IC载板行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）

3.4.3 IC载板行业市场主体数量

3.4.4 IC载板注册/在业/存续企业

3.5 中国IC载板行业招投标市场解读

3.5.1 IC载板行业招投标信息汇总

3.5.2 IC载板行业招投标信息解读

3.6 中国IC载板行业市场供给分析

3.6.1 IC载板行业产线布局及扩产计划

3.6.2 IC载板行业市场供给水平（产量）

3.7 中国IC载板行业市场需求分析

3.7.1 IC载板终端用户/行业概述

3.7.2 IC载板市场需求现状分析（需求量）

3.7.3 IC载板市场供需平衡状况（缺口仍较大）

3.7.4 IC载板市场行情走势分析

3.8 中国IC载板行业市场规模体量

3.9 中国IC载板行业市场发展痛点

第4章：中国IC载板行业市场竞争及投资并购状况

4.1 中国IC载板行业市场竞争布局状况

4.1.1 中国IC载板行业竞争者入场进程

4.1.2 中国IC载板行业竞争者省市分布热力图

4.1.3 中国IC载板行业竞争者战略布局状况

4.2 中国IC载板行业市场竞争格局分析

4.2.1 中国IC载板行业企业竞争集群分布

4.2.2 中国IC载板行业企业竞争格局分析

4.2.3 中国IC载板行业市场集中度分析

4.3 中国IC载板全球市场竞争力&国产化/国际化布局

4.4 中国IC载板行业波特五力模型分析

4.4.1 中国IC载板行业供应商的议价能力

4.4.2 中国IC载板行业消费者的议价能力

4.4.3 中国IC载板行业新进入者威胁

4.4.4 中国IC载板行业替代品威胁

4.4.5 中国IC载板行业现有企业竞争

4.4.6 中国IC载板行业竞争状态总结

4.5 中国IC载板行业投融资&并购重组&上市情况

4.5.1 中国IC载板行业投融资状况

- 1、中国IC载板行业投融资概述（资金来源及投融资主体）
- 2、中国IC载板行业投融资汇总
- 3、中国IC载板行业投融资规模
- 4、中国IC载板行业投融资解读（热门领域/融资轮次/对外投资等）
- 4、中国IC载板行业投融资趋势

4.5.2 中国IC载板行业兼并与重组

- 1、中国IC载板行业兼并与重组汇总
- 2、中国IC载板行业兼并与重组方式
- 3、中国IC载板行业兼并与重组案例
- 4、中国IC载板行业兼并与重组趋势

4.5.3 中国IC载板行业IPO动态（已上市、申请&被否情况）

第5章：中国IC载板产业链全景及配套产业发展

5.1 中国IC载板产业链——产业结构属性分析

5.1.1 IC载板产业链结构梳理

5.1.2 IC载板产业链生态图谱

5.1.3 IC载板产业链区域热力图

5.2 中国IC载板价值链——产业价值属性分析

5.2.1 IC载板行业成本投入结构

5.2.2 IC载板行业价格传导机制

5.2.3 IC载板行业价值链分析图

5.3 中国IC载板基板材料（基材）市场分析

5.3.1 IC载板基板材料（基材）类型

- 1、硬质基板材料：BT树脂、ABF材料、MIS
- 2、柔性基板材料：聚酰亚胺（PI）、PE

3、陶瓷基板材料：氧化铝、氮化铝、碳化硅等陶瓷材料

5.3.2 中国IC载板基板材料（基材）市场现状

5.3.3 中国IC载板基板材料（基材）发展趋势

5.4 中国IC载板用电解铜箔市场分析

5.4.1 IC载板用电解铜箔概述

5.4.2 中国IC载板用电解铜箔市场现状

5.4.3 中国IC载板用电解铜箔发展趋势

5.5 中国IC载板化学品/耗材市场分析

5.5.1 IC载板化学品/耗材类型（干膜、油墨、蚀刻剂、显影剂等）

5.5.2 中国IC载板化学品/耗材市场现状

5.5.3 中国IC载板化学品/耗材需求趋势

5.6 中国IC载板生产加工设备市场分析

5.6.1 中国IC载板生产加工设备类型（曝光、电镀、蚀刻、真空压膜等）

5.6.2 中国IC载板生产加工设备市场现状

5.6.3 中国IC载板生产加工设备需求趋势

5.7 配套产业布局对IC载板行业的影响总结

第6章：中国IC载板行业细分产品市场分析

6.1 中国IC载板行业细分市场概况

6.1.1 中国IC载板行业细分市场对比

6.1.2 中国IC载板行业细分市场结构

6.2 IC载板细分市场：ABF载板（硬质基板）

6.2.1 ABF载板概述

6.2.2 ABF载板市场简析

6.2.3 ABF载板发展趋势

6.3 IC载板细分市场：BT载板（硬质基板）

6.3.1 BT载板概述

6.3.2 BT载板市场简析

6.3.3 BT载板发展趋势

6.4 IC载板细分市场：柔性基板

6.4.1 柔性基板概述

6.4.2 柔性基板市场简析

6.4.3 柔性基板发展趋势

6.5 IC载板细分市场：陶瓷基板

6.5.1 陶瓷基板概述

6.5.2 陶瓷基板市场简析

6.5.3 陶瓷基板发展趋势

6.6 中国IC载板行业细分产品市场战略地位分析

第7章：中国IC载板行业细分市场需求分析

7.1 IC载板应用场景扩展&市场领域分布

7.1.1 IC载板应用场景扩展（使用场景&需求场景/消费场景）

1、IC载板市场定位

2、IC载板应用场景

2、IC载板场景扩展

7.1.2 IC载板市场领域分布（应用领域&行业应用&TO B）

1、IC载板市场领域分布

2、IC载板市场渗透概况

7.2 中国IC载板细分应用市场分析：存储芯片封装基板（eMMC）

7.2.1 中国存储芯片发展现状

7.2.2 中国存储芯片趋势前景

7.2.3 存储芯片封装基板（eMMC）概述

7.2.4 中国存储芯片封装基板（eMMC）需求现状分析

7.2.5 中国存储芯片封装基板（eMMC）市场潜力分析

7.3 中国IC载板细分应用市场分析：微机电系统封装基板（MEMS）

7.3.1 中国MEMS发展现状

7.3.2 中国MEMS趋势前景

7.3.3 微机电系统封装基板（MEMS）概述

7.3.4 中国微机电系统封装基板（MEMS）需求现状分析

7.3.5 中国微机电系统封装基板（MEMS）市场潜力分析

7.4 中国IC载板细分应用市场分析：射频模块封装基板（RF）

7.4.1 中国射频模块发展现状

7.4.2 中国射频模块趋势前景

7.4.3 射频模块封装基板（RF）概述

7.4.4 中国射频模块封装基板（RF）需求现状分析

7.4.5 中国射频模块封装基板（RF）市场潜力分析

7.5 中国IC载板细分应用市场分析：处理器芯片封装基板

7.5.1 中国处理器芯片发展现状

7.5.2 中国存处理器芯片趋势前景

7.5.3 处理器芯片封装基板概述

7.5.4 中国处理器芯片封装基板需求现状分析

7.5.5 中国处理器芯片封装基板市场潜力分析

7.6 中国IC载板细分应用市场分析：高速通信封装基板

7.6.1 中国高速通信封装基板发展现状

7.6.2 中国高速通信封装基板趋势前景

7.6.3 高速通信封装基板概述

7.6.4 中国高速通信封装基板需求现状分析

7.6.5 中国高速通信封装基板市场潜力分析

第8章：全球及中国IC载板企业布局案例解析

8.1 全球及中国IC载板主要企业布局梳理

8.2 全球IC载板主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）

8.2.1 日本揖斐电株式会社（IBIDEN）

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局&发展现状
- 4、企业IC载板业务销售&在华布局

8.2.2 韩国三星电机（SAMSUNG）

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局&发展现状
- 4、企业IC载板业务销售&在华布局

8.3 中国IC载板主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）

8.3.1 欣兴电子股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.2 景硕科技股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.3 南亚电路板股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.4 日月光半导体制造股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.5 深南电路股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.6 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.7 珠海越亚半导体股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.8 深圳丹邦科技股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.9 崇达技术股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况
- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.10 惠州中京电子科技股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
- 2、企业业务架构&经营情况

- 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
- 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
- 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
- 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

——展望篇——

第9章：中国IC载板行业发展环境洞察&SWOT分析

9.1 中国IC载板行业经济（Economy）环境分析

9.1.1 中国宏观经济发展现状

9.1.2 中国宏观经济发展展望

9.1.3 中国IC载板行业发展与宏观经济相关性分析

9.2 中国IC载板行业社会（Society）环境分析

9.2.1 中国IC载板行业社会环境分析

9.2.2 社会环境对IC载板行业发展的影响总结

9.3 中国IC载板行业政策（Policy）环境分析

9.3.1 国家层面IC载板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、国家层面IC载板行业政策汇总及解读

2、国家层面IC载板行业规划汇总及解读

9.3.2 31省市IC载板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、31省市IC载板行业政策规划汇总

2、31省市IC载板行业发展目标解读

9.3.3 国家重点规划/政策对IC载板行业发展的影响

1、国家“十四五”规划对IC载板行业发展的影响

2、《重点新材料首批次应用示范指导目录》对IC载板行业发展的影响

9.3.4 政策环境对IC载板行业发展的影响总结

9.4 中国IC载板行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

第10章：中国IC载板行业市场前景及发展趋势分析

10.1 中国IC载板行业发展潜力评估

10.2 中国IC载板行业未来关键增长点分析

10.3 中国IC载板行业发展前景预测（未来5年数据预测）

10.4 中国IC载板行业发展趋势预判（疫情影响等）

第11章：中国IC载板行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国IC载板行业进入与退出壁垒

11.1.1 IC载板行业进入壁垒分析

11.1.2 IC载板行业退出壁垒分析

11.2 中国IC载板行业投资风险预警

11.3 中国IC载板行业投资机会分析

11.3.1 IC载板产业链薄弱环节投资机会

11.3.2 IC载板行业细分领域投资机会

11.3.3 IC载板行业区域市场投资机会

11.3.4 IC载板产业空白点投资机会

11.4 中国IC载板行业投资价值评估

11.5 中国IC载板行业投资策略与建议

图表目录

图表1：IC载板术语说明

图表2：IC载板相关概念辨析

图表3：《国民经济行业分类与代码》中本报告研究行业归属

图表4：IC载板的分类

图表5：本报告研究范围界定

图表6：中国IC载板行业监管体系结构图

图表7：中国IC载板行业主管部门&行业协会&自律组织机构职能

图表8：IC载板行业标准体系框架&建设进程（国家/地方/行业/团体/企业标准）

图表9：中国IC载板行业现行&即将实施标准汇总

图表10：中国IC载板行业重点标准及其影响解读

图表11：本报告数据资料来源汇总

图表12：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表13：全球IC载板行业标准体系&技术进展

图表14：全球IC载板行业发展历程&产品演进

图表15：全球IC载板行业兼并重组状况

图表16：全球IC载板行业市场竞争格局

图表17：全球IC载板行业市场发展现状

图表18：全球IC载板行业供需状况

图表19：全球IC载板行业细分市场分析

图表20：全球IC载板企业兼并重组状况

图表21：全球IC载板行业市场竞争格局

图表22：全球IC载板行业区域发展格局

图表23：全球IC载板行业重点区域市场分析

图表24：全球IC载板行业市场规模体量分析

图表25：全球IC载板行业市场规模体量分析

图表26：全球IC载板行业市场前景预测（未来5年预测）

图表27：全球IC载板行业发展趋势洞悉

图表28：全球IC载板行业发展经验总结和有益借鉴

图表29：中国IC载板行业发展历程

图表30：IC载板行业科研投入状况（研发力度及强度）

图表31：IC载板行业科研投入（力度及强度）

图表32：IC载板行业科研创新（专利与转化）

图表33：IC载板行业关键技术（现状与发展）

图表34：中国IC载板行业关键技术分析

图表35：中国IC载板行业工艺类型/技术路线分析

图表36：IC载板行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）

图表37：IC载板行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）

图表38：IC载板行业市场主体数量

图表39：IC载板注册/在业/存续企业

图表40：中国IC载板行业招投标市场解读

图表41：中国IC载板行业市场供给分析

图表42：中国IC载板行业市场供给能力分析

图表43：中国IC载板行业市场供给水平分析

图表44：中国IC载板行业市场需求分析

图表45：中国IC载板行业市场规模体量分析

图表46：中国IC载板行业市场发展痛点分析

图表47：中国IC载板行业竞争者入场进程

图表48：中国IC载板行业竞争者区域分布热力图

图表49：中国IC载板行业竞争者发展战略布局状况

图表50：中国IC载板行业企业战略集群状况

图表51：中国IC载板行业企业竞争格局分析

图表52：中国IC载板行业企业竞争格局分析

图表53：中国IC载板行业市场集中度分析

图表54：中国IC载板全球市场竞争力&国产化/国际化布局

图表55：中国IC载板行业供应商的议价能力

图表56：中国IC载板行业消费者的议价能力

图表57：中国IC载板行业新进入者威胁

图表58：中国IC载板行业替代品威胁

图表59：中国IC载板行业现有企业竞争

图表60：中国IC载板行业竞争状态总结

图表61：中国IC载板行业资金来源

图表62：中国IC载板行业投融资主体

图表63：中国IC载板行业投融资汇总

图表64：中国IC载板行业投融资规模

图表65：中国IC载板行业投融资解读

图表66：中国IC载板行业兼并与重组汇总

图表67：中国IC载板行业兼并与重组方式

图表68：中国IC载板行业兼并与重组案例

图表69：中国IC载板行业兼并与重组趋势

图表70：IC载板产业链结构梳理

图表71：IC载板产业链生态图谱

图表72：IC载板产业链区域热力图

图表73：IC载板行业成本投入结构分析

图表74：IC载板行业价值链分析图

图表75：IC载板基板材料（基材）类型

图表76：中国IC载板基板材料（基材）市场现状

图表77：中国IC载板基板材料（基材）发展趋势

图表78：IC载板用电解铜箔概述

图表79：中国IC载板用电解铜箔市场现状

图表80：中国IC载板用电解铜箔发展趋势

图表81：IC载板化学品/耗材概述

图表82：中国IC载板化学品/耗材市场现状

图表83：中国IC载板化学品/耗材发展趋势

图表84：中国IC载板行业细分市场结构

图表85：中国ABF载板市场简析

图表86：中国BT载板市场简析

图表87：中国柔性基板市场简析

图表88：中国陶瓷基板市场简析

图表89：中国IC载板行业细分产品市场战略地位分析

图表90：IC载板应用场景扩展（使用场景、用户场景、需求场景/消费场景）

图表91：IC载板市场领域分布（应用领域&行业应用&TO B）

图表92：中国存储芯片发展现状

图表93：中国存储芯片趋势前景

图表94：存储芯片封装基板（eMMC）概述

图表95：中国存储芯片封装基板（eMMC）需求现状分析

图表96：中国存储芯片封装基板（eMMC）市场潜力分析

图表97：中国MEMS发展现状

图表98：中国MEMS趋势前景

图表99：微机电系统封装基板（MEMS）概述

图表100：中国微机电系统封装基板（MEMS）需求现状分析

图表101：中国微机电系统封装基板（MEMS）市场潜力分析

图表102：中国射频模块发展现状

图表103：中国射频模块趋势前景

图表104：射频模块封装基板（RF）概述

图表105：中国射频模块封装基板（RF）需求现状分析

图表106：中国射频模块封装基板（RF）市场潜力分析

图表107：中国处理器芯片发展现状

图表108：中国处理器芯片趋势前景

图表109：处理器芯片封装基板概述

图表110：中国处理器芯片封装基板需求现状分析

图表111：中国处理器芯片封装基板市场潜力分析

图表112：中国高速通信封装基板发展现状

图表113：中国高速通信封装基板趋势前景

图表114：高速通信封装基板概述

图表115：中国高速通信封装基板需求现状分析

图表116：中国高速通信封装基板市场潜力分析

图表117：全球及中国IC载板主要企业布局梳理

图表118：欣兴电子股份有限公司发展历程

图表119：欣兴电子股份有限公司基本信息表

图表120：欣兴电子股份有限公司股权穿透图